

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

公告编号：2023-053

合肥新汇成微电子股份有限公司 关于拟签署项目投资合作协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资项目名称：汇成二期项目。
- 投资金额：汇成二期项目占地约 57 亩，计划分阶段进行投资建设。第一阶段总投资约 10 亿元，主要用于拓展先进封装测试产能，并依托现有技术延伸产线工艺至车载芯片封装测试等领域。项目后续阶段投资计划视合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一阶段投产情况及市场环境等因素另行协商确定。公司拟在项目第一阶段先行投资约 6 亿元用于新建车载显示芯片项目。
- 风险提示：
 - 1、本次项目投资合作协议的签署符合公司发展战略和规划，但仍然面临政策、市场变化对项目进展造成不确定性影响的风险。同时投资项目尚处于论证阶段，项目涉及的投资总额和具体实施内容等存在变动可能。
 - 2、本次项目投资合作协议所涉及的项目用地尚需通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，项目投资和实施以竞买目标土地为前提，土地使用权的最终成交价格及取得时间具有不确定性。
 - 3、本次项目投资合作协议所涉项目的实施尚需政府部门进行项目备案、建设项目环境影响评价审批、节能评估和审查等前置审批手续。此外，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。

4、本次项目投资合作协议涉及投资金额较大，资金来源为公司自有资金或自筹资金，可能存在因资金未能按期足额到位导致项目建设周期延长或无法按期完成的风险。另外未来贷款利率波动，可能会对公司项目融资产生不利影响。公司将根据项目时间安排及实际资金需求，合理统筹安排资金。

5、项目投产后，可能由于宏观经济形势、产业政策、产品价格、销售渠道及市场开拓情况等因素发生变动，导致投资项目不能达到预期的经济效益，将会给公司带来经营业绩波动风险。

6、项目达产后，若每期项目亩均税收未达约定条件，则公司将面临以现金补齐差额部分，且政府有权停止后期供地及相关合作的风险。

7、项目最终投资规模和建设周期具有不确定性，并且不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。本次项目投资合作协议的签署预计对公司 2023 年度的经营成果不产生重大影响，对未来经营业绩的影响尚不确定。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司与安徽合肥新站高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“合肥新站高新区管委会”）拟签署项目投资合作协议，公司拟在合肥市新站区合肥综合保税区内投资建设汇成二期项目。项目占地约 57 亩，计划分阶段进行投资建设。第一阶段总投资约 10 亿元，主要用于拓展先进封装测试产能，并依托现有技术延伸产线工艺至车载芯片封装测试等领域。项目后续阶段投资计划视公司第一阶段投产情况及市场环境等因素另行协商确定。公司拟在项目第一阶段先行投资约 6 亿元用于新建车载显示芯片项目。

（二）决策与审议程序

公司于 2023 年 9 月 8 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟签署项目投资合作协议的议案》，同意公司与合肥新站高新区管委会签署《汇成二期项目投资合作协议》。本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

(三) 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将按照相关法律法规规定办理具体事项和履行信息披露义务。

二、合作协议主体的基本情况

(一) 交易双方基本情况

甲方：安徽合肥新站高新技术产业开发区管理委员会

地址：安徽省合肥市文忠路 999 号

合肥新站高新区管委会是合肥新站高新技术产业开发区的行政管理机构。

乙方：合肥新汇成微电子股份有限公司

地址：合肥市新站区合肥综合保税区内

(二) 合肥新站高新区管委会与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系。

三、合作协议的主要内容

(一) 项目概况

1、项目名称：汇成二期项目。

2、项目投资额：项目第一阶段总投资约 10 亿元。

3、项目内容：项目占地约 57 亩，第一阶段总投资约 10 亿元，主要用于拓展先进封装测试产能，并依托现有技术延伸产线工艺至车载芯片封装测试等领域。

4、指标约定：项目自土地出让合同签订之日起 18 个月内建成，土地出让合同约定竣工时间起 12 个月内投产。项目第一阶段自土地出让合同约定竣工时间起 36 个月内达产。项目投产后，工业项目累计投资不低于 400 万元/亩。项目第一阶段达产后，亩均税收不低于 30 万元/年。

(二) 项目用地

项目选址位于汇成一期项目地块东侧（最终以实测为准），具体位置与准确四至界限以《合肥市规划（单体）设计条件通知书》为准。

甲方协助乙方采用挂牌方式以不低于国家规定的价格取得国有建设用地使用权。乙方应该按照规定参与项目用地的出让程序，并签署《国有土地使用权

出让合同》，并按合同履行。乙方自取得《国有土地使用证》之日起对该土地拥有完全的、合法的权利。

（三）权利与义务

协议各方按照本协议分别约定各方的权利和义务。甲方积极协助乙方开展区域市场产业链场景对接，并提供适当的政策支持。乙方应尽快推动项目进展。

（四）协议解除

本入区项目最终确定以项目环评、安评等通过为前提，如环评、安评等没有通过，本协议将自动失效。

（五）争议解决

甲乙双方因执行本协议发生争议的，由争议双方友好协商解决；协商不成的，双方可向项目所在地法院提起诉讼。

（六）签署与生效

本协议自甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字、盖章之日生效。

四、新建车载显示芯片项目概况

车载显示系统主要包括传统的中控屏、仪表盘，以及新兴的 HUD 抬头显示、电子后视镜、副驾驶/后排屏等。车载显示在汽车系统中占有重要地位，一方面，车载显示是辅助行车、体验娱乐必不可少的主要接口；另一方面，屏机分离趋势下，高算力芯片、OTA 为多屏化发展提供基础，车载显示功能不断扩充。在智能驾驶、智慧座舱升级换代的背景下，车载显示屏幕尺寸和数量显著上升。

经过前期充分的市场调研和客户论证，公司预期车载显示芯片有足够的市场空间和需求增速。为拓展业务领域、扩大经营规模、增强盈利能力和抗风险能力，公司拟于本次签署项目投资合作协议后在汇成二期项目投资约 6 亿元用于新建车载显示芯片项目。该项目基本情况如下：

（一）项目名称：新建车载显示芯片项目。

（二）项目主要内容：新建厂房购置设备建设车载显示驱动芯片晶圆金凸块制造、晶圆测试、覆晶封装生产线。

（三）项目投资规模：约 6 亿元。

（四）资金来源：自有资金或自筹资金。

（五）项目选址：合肥市新站区合肥综合保税区内汇成二期项目预留地块（紧邻公司现有生产经营办公场地）。

五、对外投资对上市公司的影响

合肥是中国集成电路产业中心城市，政府大力推进集成电路产业和新能源汽车产业的集群发展，具有良好的集成电路产业基础和经营环境。合肥新站高新技术产业开发区近年来奋力打造新型显示、新能源及新材料两个千亿级产业集群，着力培育集成电路等五个超百亿级支柱产业集群，区内新型显示已发展为国内集群效应较为显著的产业基地。

本次对外投资项目位于合肥市高新技术产业开发区合肥综合保税区内，紧邻公司现有生产经营办公场地，公司将充分借助合肥市集成电路和汽车产业配套优势、政策扶持优势和新型显示产业集群优势，利用公司在区域内深耕多年积累的业务基础，把握车载显示芯片行业发展机遇，进一步完善公司在显示驱动芯片领域的产业布局，扩大公司集成电路封装测试生产规模，提高产品供应能力和市场占有率，提升公司品牌影响力和综合竞争力，增强盈利能力和抗风险能力，符合公司中长期发展战略规划，符合全体股东的长远利益。

公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不存在损害公司及股东利益的情形。本项目尚处于筹划阶段，在协议签署后尚需完成项目备案、土地购置、环境影响评价等流程，项目建设资金支出将根据经营计划、项目进展情况有节奏的统筹安排，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，预计对公司 2023 年度经营业绩不会构成重大影响。本次对外投资不会影响现有主营业务的正常开展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

六、本次对外投资的风险分析

（一）本次项目投资合作协议的签署符合公司发展战略和规划，但仍然面临政策、市场变化对项目进展造成不确定性影响的风险。同时投资项目尚处于论证阶段，项目涉及的投资总额和具体实施内容等存在变动可能。

（二）本次项目投资合作协议所涉及的项目用地尚需通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，项目投资和实施以竞买目标土地为前提，土地使用权的最终成交价格及取得时间具有不确定性。

（三）本次项目投资合作协议所涉项目的实施尚需政府部门进行项目备案、建设项目环境影响评价审批、节能评估和审查等前置审批手续。此外，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。

（四）本次项目投资合作协议涉及投资金额较大，资金来源为公司自有资金或自筹资金，可能存在因资金未能按期足额到位导致项目建设周期延长或无法按期完成的风险。另外未来贷款利率波动，可能会对公司项目融资产生不利影响。公司将根据项目时间安排及实际资金需求，合理统筹安排资金。

（五）项目投产后，可能由于宏观经济形势、产业政策、产品价格、销售渠道及市场开拓情况等因素发生变动，导致投资项目不能达到预期的经济效益，将会给公司带来经营业绩波动风险。

（六）项目达产后，若每期项目亩均税收未达约定条件，则公司将面临以现金补齐差额部分，且政府有权停止后期供地及相关合作的风险。

（七）项目最终投资规模和建设周期具有不确定性，并且不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。本次项目投资合作协议的签署预计对公司 2023 年度的经营成果不产生重大影响，对未来经营业绩的影响尚不确定。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2023年9月9日